

证券代码：688516

证券简称：奥特维

### 无锡奥特维科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	易方达基金、华夏基金、南方基金、嘉实基金、德邦基金、平安基金、国寿安保基金、中加基金、新华资管、平安资管、复兴锐正、中金公司、东吴证券、国海证券、华西证券、山西证券
时间	2026年2月
地点	无锡奥特维科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书周永秀女士、证券部李翠芬、陶敏燕、张秋仪、缪子健
<b>投资者关系活动主要内容</b>	
	<p><b>Q：当前串焊机设备有哪些技术路线方向值得关注？</b></p> <p>A：公司当前关注串焊机设备的2条技术路线：（1）OBB工艺：OBB工艺导入后在降本增效方面表现良好，公司的焊接+施胶方案具备较高的工艺成熟度已得到客户的认可，2025年已有批量改造订单落地，预计今年OBB工艺的设备改造需求仍将持续；（2）多分片工艺：公司持续与客户合作进行多分片技术的研发，目前已收到龙头客户的批量订单，若运行数据良好，有望推动公司新型串焊机设备业务发展。</p> <p><b>Q：面对当前的市场情况，公司锂电设备业务进行了怎样的战略调整？</b></p> <p>A：目前公司模组/PACK设备应用已从动力电池领域扩展至储能行业，受益于储能行业需求回升，公司储能设备订单持续增长。此外，公司高度重视固态电池技术发展，公司与行业知名客户合作研发硫化物固态电池设备，已有部分设备发往客户端验证。</p> <p><b>Q：请大致介绍一下公司半导体铝线键合机设备的发展情况，目前的该设备盈利能力怎样？</b></p> <p>A：公司于2018年立项研发铝线键合机，设备性能对标国外一线品牌，2024-2025年已收获客户批量订单，是公司半导体设备业务重要的组成部分。目前公司正持续关注半导体封装的新工艺如混合键合、倒装芯片封装等的进展，力争把握新赛道的发展机会。随着订单规模的增长，公司铝线键合机设备的盈利能力已得到明显改善，未来有望进一步提升。</p> <p><b>Q：AI与算力资本投入发展对公司相关设备的影响如何？</b></p> <p>A：由于全球AI技术的快速迭代与算力基础设施建设的资本投入持续加码，数据中心对高速率光模块的需求持续增长。伴随AI大模型训练对光模块速率等级要求的提升，800G-1.6T的光模块有望成为主流。当光模块升级至800G以上后，人工质检效率不高且质量不稳定，需要使用AOI设备提升检测的效率与质量。因此若未来800G-1.6T的光模块成为主流，将利好</p>

	公司 AOI 设备业务的发展。
日期	2026 年 3 月 3 日